

来場登録はこちらをクリック(無料)

南展示棟

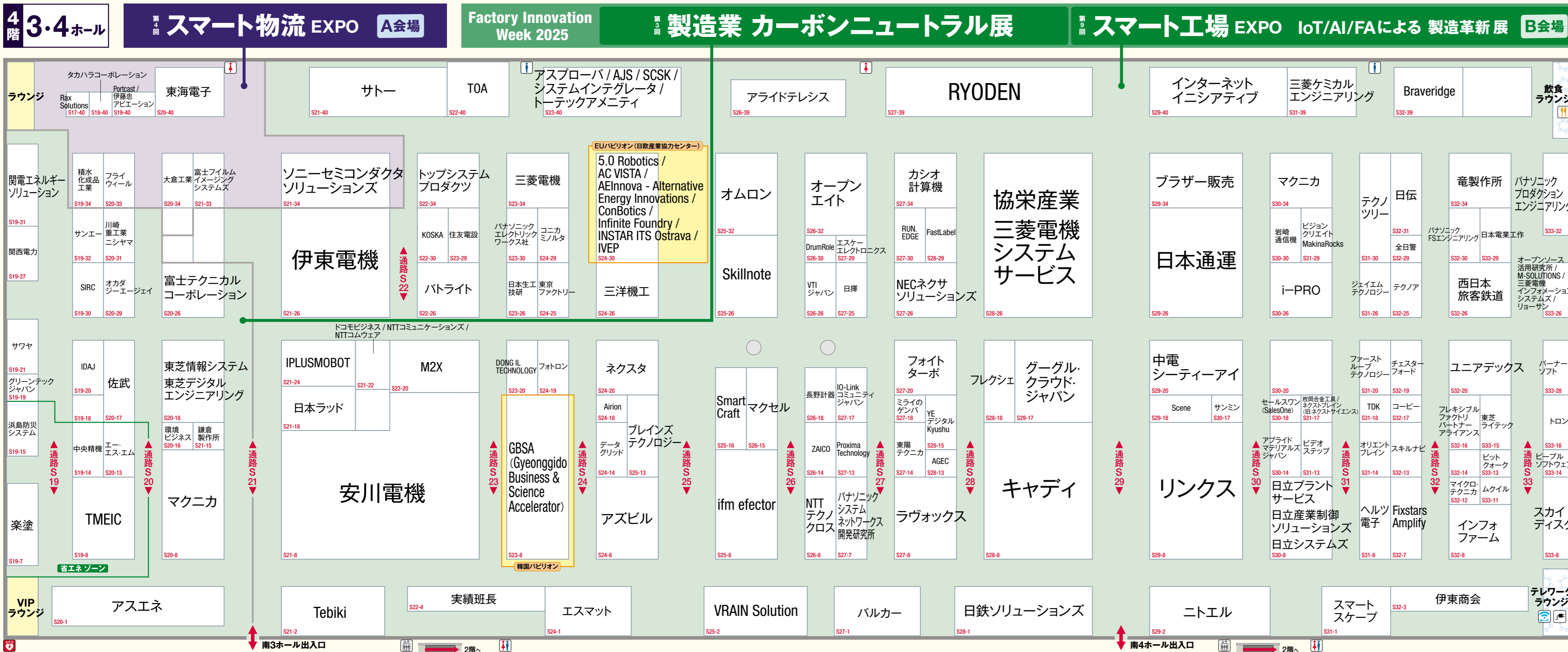
会場案内図

会期 2025年1月22日[水]~24日[金] 10:00~17:00

会場 東京ビッグサイト

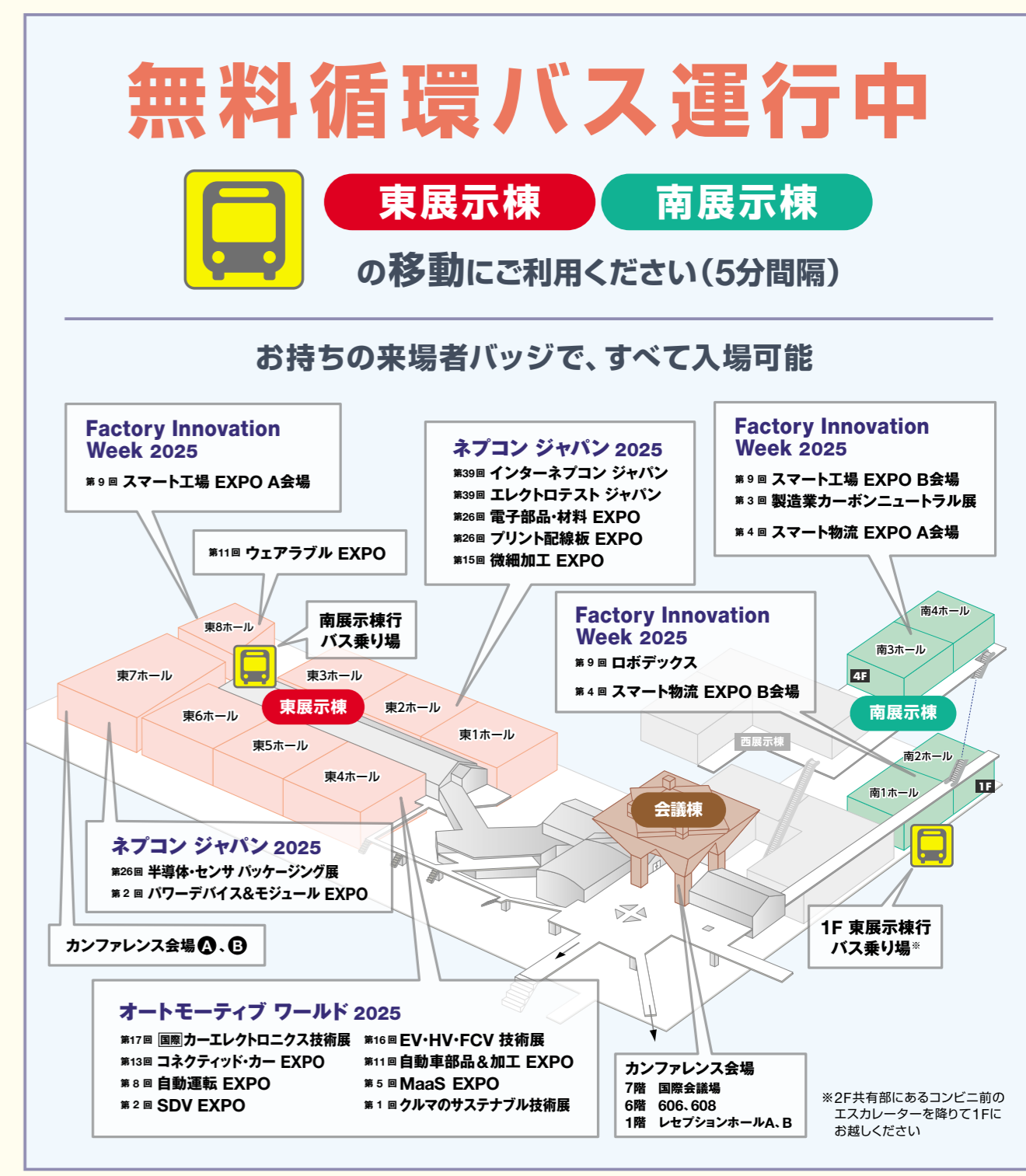
主催 RX Japan株式会社

©2024年11月27日現在。実際のレイアウトと異なる場合がございます。



お目当ての会社の探し方
1 スマホで出展社検索サイトにアクセス
2 お目当ての会社を検索して小間番号を確認
3 小間番号から案内図でブースの位置をお探しいただき

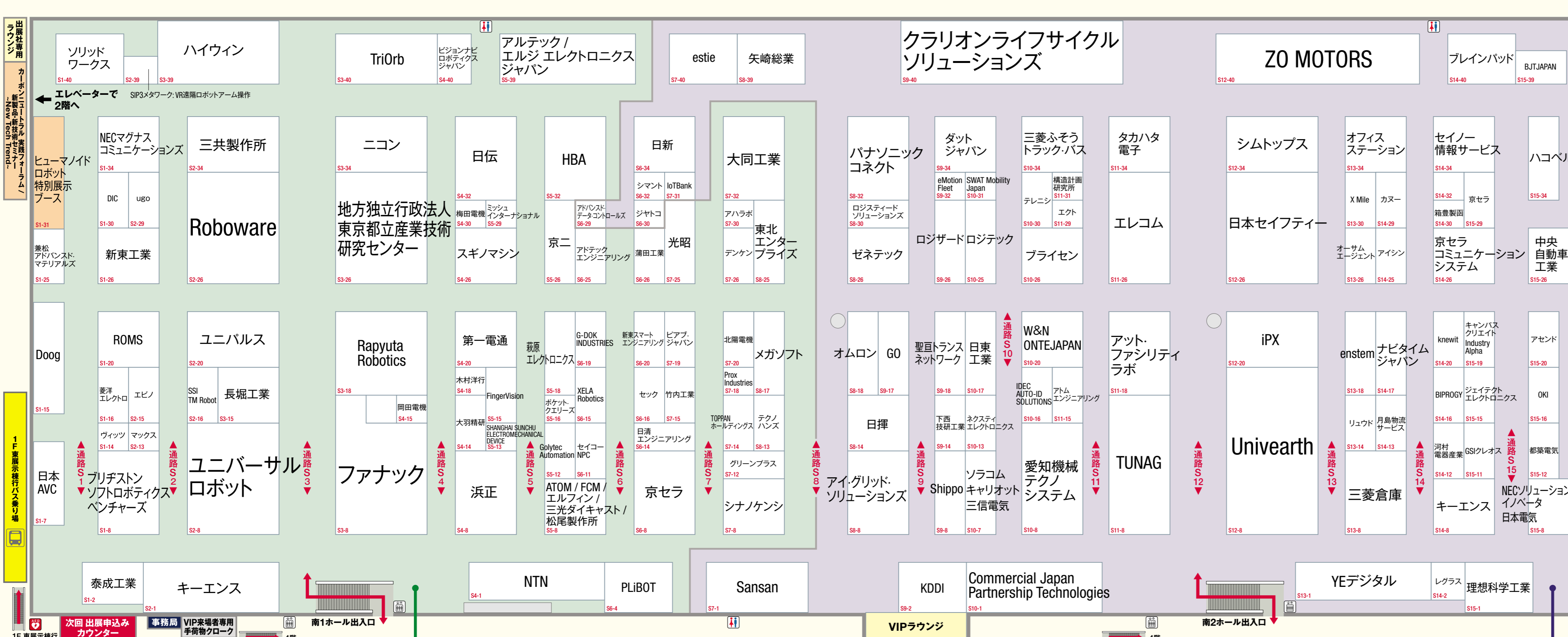
スマート工場 EXPOは 東8ホールでも開催中



ロボットの進化を肌で感じる!
ヒューマノイドロボット 特別展示企画
会場: 南1ホール
小間番号: S1-31

RFID 読み取り体験実施中
設備予備品管理
会場: 南1ホール

東展示棟 会場案内図は裏面へ



1階 1.2ホール Factory Innovation Week 2025 ロボデックス ロボット [開発]・[活用]展

4階 3.4ホール スマート物流 EXPO A会場

4階 3.4ホール スマート物流 EXPO B会場

来場登録はこちらをクリック(無料)

東展示棟 会場案内図

2025年1月22日(水)~24日(金) 東京ビッグサイト RX Japan株式会社

お目当ての会社の探し方

- 1 スマホで出展社検索サイトにアクセス
- 2 お目当ての会社を検索して小間番号を確認
- 3 小間番号から案内図でブースの位置をお探ください



世界的なクルマのハッキングコンテストを開催中

会場: 東6ホール 小間番号: E58-E53

世界から集まったチームが、下記4領域のハッキングを競う!

- 自動車 (自動車メーカー)
- インフォテインメント (AV/AVC)
- 電気自動車 (EV)
- オペレーティングシステム (OS)

詳細はこちら: <https://vicone.com/jp/pwn2own-automotive>

新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~の最新情報ははこちら

申込不要。聴講を希望される方は、直接会場へお越しください。

<https://www.nepconjapan.jp/foxy/ja-jp/conference/ex-presentation.html>

その他カンファレンス・フォーラムの最新情報ははこちら

一部、事前申込制となります。聴講を希望される方はお申込の上、会場へお越しください。

<https://www.nepconjapan.jp/foxy/ja-jp/conference.html>

凡例

- トイレ 売店 Wi-Fi AED ラウンジ
- エレベーター コンセント

会場のVR/AR/AR設備については、こちらからご確認ください。

NTT Data SDV

東6ホール E57-E8

STANLEY Engineered Fastening

EV向けの優れた軽量化システム「プラズマを活用」 E58-8ブースでお見せします。

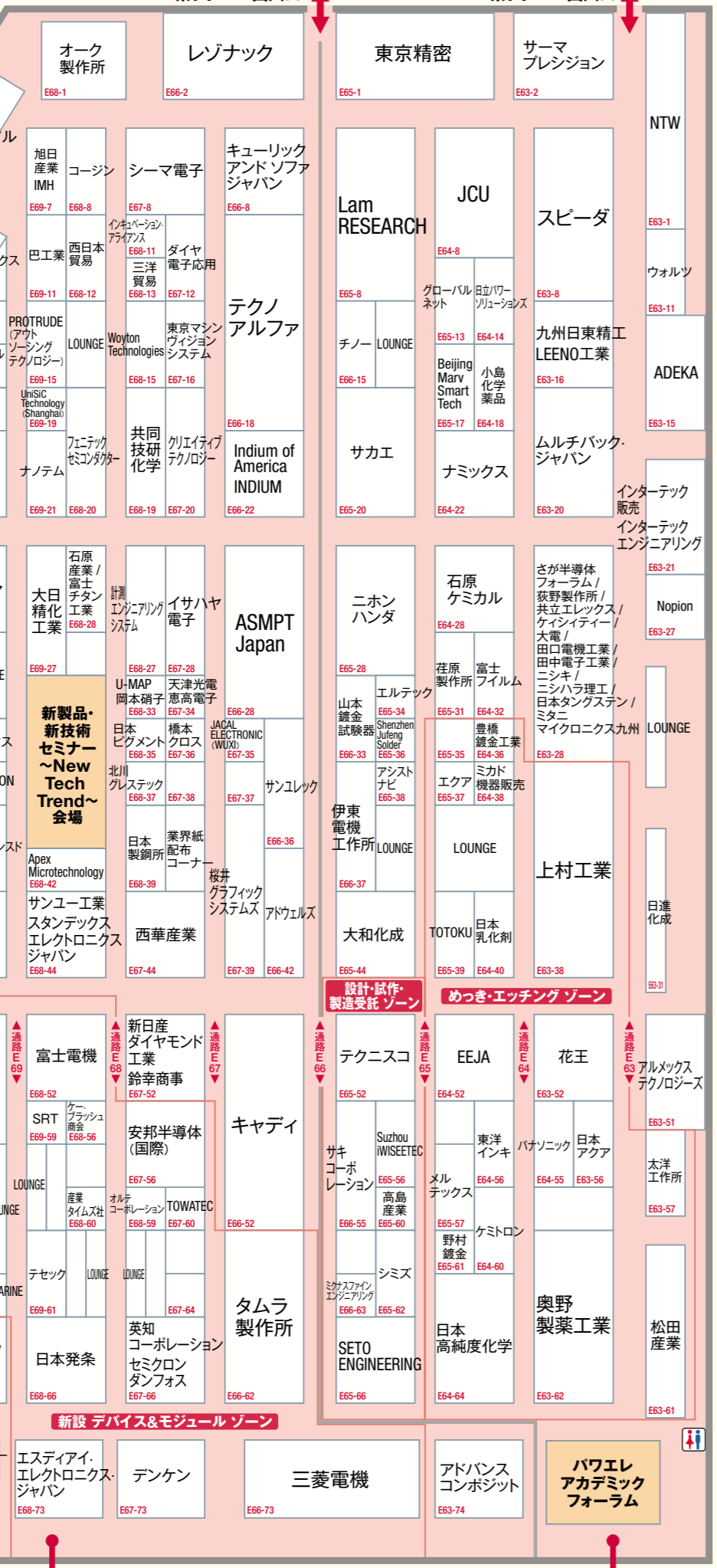
南展示棟 会場案内図は ←裏面へ

ウェアラブル EXPO

ウェアラブル 開発・活用展



スマート工場 EXPO A会場



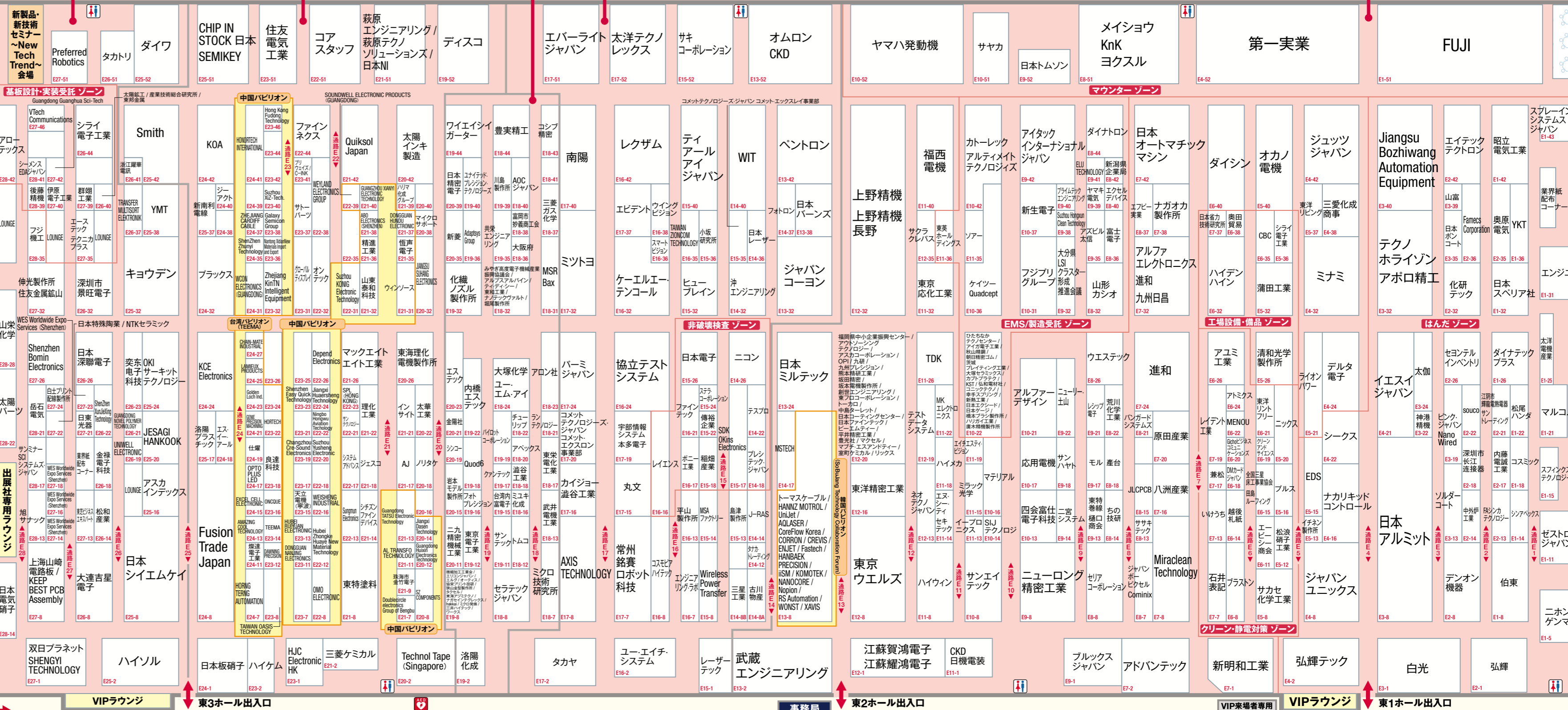
プリント配線板 EXPO

電子部品・材料 EXPO

微細加工 EXPO

エレクトロテストジャパン

インターネットジャパン

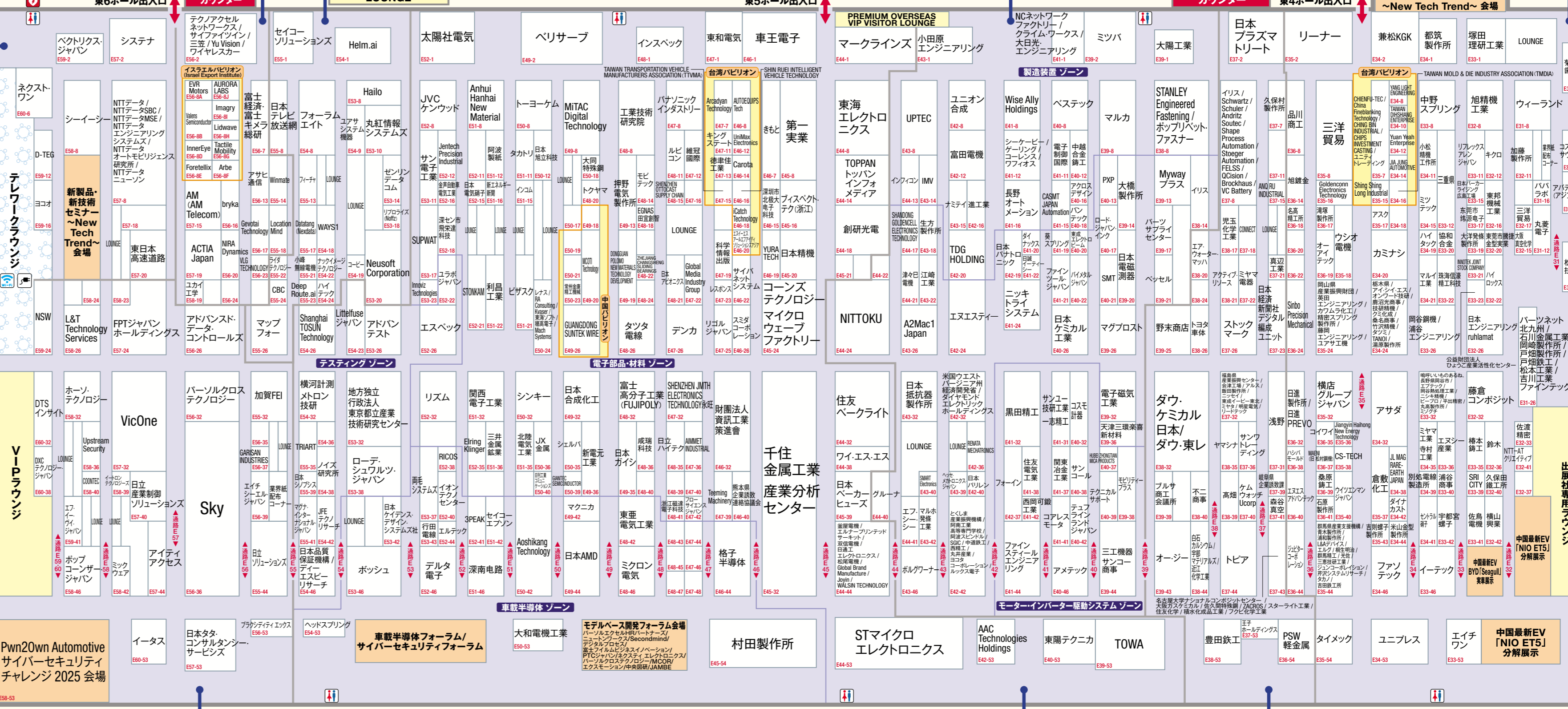


コネクティッドカー EXPO

自動運転 EXPO

EV・HV・FCV 技術展

自動車部品・加工 EXPO



パワーデバイス&モジュール EXPO

半導体・センサ パッケージング展

MaaS EXPO

SDV EXPO 車載ソフトウェア開発展

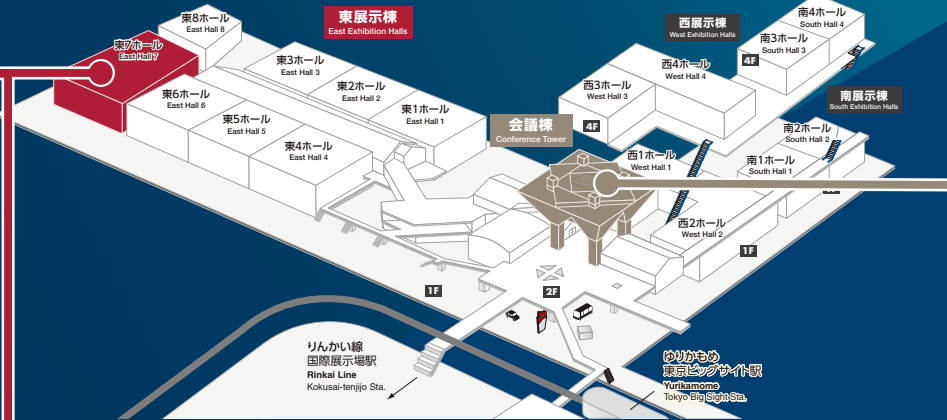
カーエレクトロニクス技術展

カンファレンスプログラム

CONFERENCE VENUE OVERVIEW

1月22日 [水]

Jan.22 [Wed.]



カンファレンス会場 A CONFERENCE VENUE A

NEPCON-S1 変革する電子業界のトレンドを読み解く
Forecast of the Transforming Electronics Industry
10:00-11:10
主催: 株式会社 日立 取締役 会長 渡辺 謙
Hitachi, Chairman Shigeo Saito, Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan

AUTO-MS1 高齢化社会におけるモビリティの価値創造
Mobility in an Aging Society
12:30-13:40
主催: ジェネックス(株) 代表取締役 笠原 一
Genex, Inc., Representative Director Kazuhisa Kasahara, Tokyo, Japan
マナブ R&D 開発企画本部 開発戦略企画部 主任 橋岡 孝宏
Manabu, R&D Program Management, Development Strategy Planning Dept., R&D Strategy Planning Div., Manabu, Inc., Tokyo, Japan

PDM-S1 進化する車載パワーデバイス！
リーディングカンパニーの最新技術
Power Devices for Automotive Applications: Latest Technologies of Leading Companies
15:00-16:10
主催: (株)デンソー エレクトロニクス(株) 代表取締役 高橋 孝宏
Denso, Representative Director Takahisa Takahashi, Toyota Motor Corp., Tokyo, Japan
S1 マイクロエレクトロニクス(株) 代表 芳尾 桂
S1 Microelectronics, Representative Director Kei Yoshino, Tokyo, Japan

カンファレンス会場 B CONFERENCE VENUE B

WEA-K データ活用で社員を守る！ウェアラブルデバイスが
切り拓く次世代の健康経営支援
Next-Generation Health Support Enabled by Wearable Devices
10:00-11:10
主催: 経済産業省 商工サービスグループ ヘルスケア産業課 課長 橋本 敬輔
Ministry of Economy, Trade and Industry, Health Care Industry Division, Director Takahisa Hashimoto, Tokyo, Japan
(株)NTTPC コミュニケーション サービスグループ 営業部長 吉田 健
NTTPC Communications Service Group, Sales Manager Ken Yoshida, Tokyo, Japan

NEPCON-S2 注目の中工程における最新の重要技術や取り組みを紹介
Key Technologies and Initiatives in "Mid-End" Process
12:30-13:40
主催: ラミラワー Panel Product Line WETS S. Director, Head of Bi Develop Frank Su
Lamirawa, S. Director Frank Su, Head of Bi Develop Product Line, Lamirawa, Ltd., Tokyo, Japan
AGC(株) 電子カンパニー ASPソリューション 技術開発グループ マネージャー 佐竹 昇
AGC Electronics Company, Technology Development Group Manager Nobuhiko Sakaki, Tokyo, Japan
AGC(株) 電子カンパニー ASPソリューション TGIグループ 開発推進チーム マネージャー 宇山 洋平
AGC Electronics Company, Technology Development Group Manager Yohei Uryama, Tokyo, Japan

AUTO-SDV6 エンド・ツー・エンド・モデルがもたらす
自動運転のパラダイムシフト
The Autonomous Driving Paradigm Shift Empowered by End-to-End Model
15:00-15:50
主催: DeepRoute.ai, CEO, Maxwell Zhou
Maxwell Zhou, CEO, DeepRoute.ai, Beijing, China

7
国際会議場
INTERNATIONAL CONFERENCE HALL

AUTO-K 10:00-11:10
【特別対談】SDV時代に、新たなUx、サービスモデル、
収益を生み出すために必要なことは？
Special Discussion: UX and Services & Business Models with SDV
主催: 日産自動車(株) フェロー 電子メカロニクス 電装システム部長 佐々木 徹夫
Nissan, Fellow Kazuo Sasaki, Nissan North America, Inc., North America, USA
パソニック オートモティブシステムズ(株) 代表取締役 副社長 野村 隆夫
Panasonic Automotive Systems, Representative Director Ryoma Nomura, Tokyo, Japan
BT(イノベーション) 副社長 サイバーセキュリティ 部長 知野 隆夫
BT (Innovation) Deputy President Ryoichi Chino, Tokyo, Japan
プロトタイプ コンカリング(株) 執行役員 パートナー ビジネス ストラテジー プラクティス リーダー 鹿島 庸
Proto Type Conclaring, Executive Director Yasuhisa Kishimoto, Tokyo, Japan

ISP-1 12:30-14:00
AIのさらなる進化に必要な不可欠な
パッケージング技術の最新動向
Further Evolution of AI: Essential Packaging Technology for the Future
主催: Qualcomm Technologies セミコンダクターデバイス
エジニケーション シニア ディレクター Yang Zhang
Qualcomm Technologies, Senior Director Yang Zhang, San Diego, CA, USA
Samsung Electronics テストシステム(株) 開発チーム 部長 Jeongho Lee
Samsung Electronics, Development Team Manager Jeongho Lee, Seoul, South Korea

FIW-K 15:00-16:10
AI、生成AIで製造現場はどう変わった？最新事例を学ぶ
How Has Generative AI and AI Transformed the Manufacturing Industry?
主催: 日産自動車(株) 開発執行役員 車両生産技術開発本部部長 平田 祐治
Nissan, Development Executive Director Yasuhisa Hirata, Nissan North America, Inc., North America, USA
日立 代表取締役 副社長 佐藤 隆夫
Hitachi, Representative Director Takahisa Sato, Tokyo, Japan
ISSO(株) デジタルソリューションセンター 部長 ビジネス デベロップメント ディレクター 森田 孝幸
ISSO, Manager Ken Mori, Tokyo, Japan

6
606

AUTO-CN2 10:00-10:50
ホンダのリソースサーキュレーションと
サステナブルマテリアル技術
Honda's Resource Circulation and Sustainable Materials Technology
主催: (株)本田技研研究所 材料研究センター リジリエンス材料研究室
Sustainable Materials Manager Chihiro Yamamoto, Honda R&D Co., Ltd., Tokyo, Japan

AUTO-SDV3 12:30-14:00
日本と世界の最新チップレット技術
車載半導体はどのように進化するか
The Latest Chiplet Technologies in Japan and Around the World
→ How Will it Evolve Semiconductors Evolve?
主催: Rapidus(株) 3Dセンサ本部長 専任執行役員 3Dセンサ本部長 折井 清光
Rapidus, 3D Sensor Division Manager Shigeaki Orii, Tokyo, Japan
AMD Adaptive and Embedded Computing Group, Core Markets Group,
Automotive Head of APAC and North America Product Marketing, Automotive ADAS, Rehman Tahir
AMD, Automotive Head of APAC and North America Product Marketing, Rehman Tahir, Austin, Texas, USA

ISP-2 15:00-16:30
ガラスパッケージ基盤における先端技術と今後の展望
Advanced technology and future prospects for glass package substrates
主催: 3D System Scaling, Founder and President, Venky Sundaram
3D System Scaling, Founder and President, Venky Sundaram, Bangalore, India
Intel, Substrate Packaging TD, Intel Foundry,
Principal Engineer and Director, Backend Area, Gang Duan
Intel Foundry, Principal Engineer and Director, Backend Area, Gang Duan, Taipei, Taiwan

1
レセプション
ホール
RECEPTION HALL A

FIW-S1 10:00-11:10
【事例紹介】工場の脱炭素化に向けた製造業の挑戦
-Case Study- Challenges to Decarbonize Factories
主催: AGC(株) 建築ガラス アジアカンパニー 技術経営基盤推進グループグループリーダー 長尾 祐希
AGC, Building Glass Asia Company, Technology Management Group Leader Naohiko Nagano, Tokyo, Japan
富士電機(株) 情報ソリューション事業部 システム開発部長 中野 隆夫
Fujitsu, Information Solution Business, System Development Manager Ryuuichi Nakano, Tokyo, Japan

PWB-1 12:30-14:00
IoTキーデバイスであるスマートフォンの
最新市場/技術動向
Latest Market Technology Trend for Smartphones as Key IoT Device
主催: セミコンダクト 代表 上田 弘孝
Semiconductor, Representative Director Hiroyuki Ueda, Tokyo, Japan

PWB-2 15:00-16:30
半導体パッケージ、サブストレート、
マザーボードの最新技術
Latest Technology in Semiconductor Package, Package substrate and Main Board.
主催: ルネサスエレクトロニクス(株) シニア マネージャー 堀 龍明
Renesas Electronics, Senior Manager Ryumasa Hori, Tokyo, Japan
(株)メテオ 技術マーケティング企画室 室長 戸田 光昭
Meteo, Technical Marketing Planning Room, Room Manager Mitsuharu Tada, Tokyo, Japan

1
レセプション
ホール
RECEPTION HALL B

SLE-K 10:00-11:10
2024年問題を乗り越える！
人手不足対策と物流効率化事例に迫る
Overcoming 2024 Challenges! Exploring Solutions for Labor Shortage and Logistics Efficiency
主催: サントリーホールディングス(株) サリテーション本部
イノベーション推進部長 ササキ 隆夫
Santitas, Innovation Promotion Department Manager Takahisa Sasaki, Tokyo, Japan
(株)ランドールバグ パートナー 小野塚 直志
Randall Bag, Partner Naohisa Onozuka, Tokyo, Japan

FIW-S2 12:30-13:40
AIで進むロボットの知能化。共に働く未来と社会実装への挑戦
Robot Intelligence Advancing with AI: The Future of Working Together and the Challenge of Social Implementation
主催: (株)デンソー 研究開発センター 執行役員 成道 剛志
Denso, Research Development Center Executive Director Takahisa Naruse, Toyota Motor Corp., Tokyo, Japan
京セラ(株) エコパック2事業部 事業推進部長 野村 守
Kyocera, Eco Pack 2 Business Unit, Business Development Manager Ken Nomura, Kyoto, Japan

AUTO-SDV51 15:00-16:10
SDV開発における発想の転換の必要性
SDV Development: Mindset Shift is the Key
主催: ルネサスエレクトロニクス(株) ハイパフォーマンスコンピューティングプロダクトグループ
HPC SoC/ソフトウェアチームマネージャ シニア ディレクター 岩倉 隆博
Renesas Electronics, HPC SoC/Software Team Manager Hiroyuki Iwaki, Tokyo, Japan
本田技研工業(株) SDV事業開発部 技術開発部 ディレクター 日下 隆夫
Honda Motor Co., Ltd., SDV Business Development Dept. Technical Development Dept. Director Takahisa Hishida, Tokyo, Japan
インフォティメントシステムズ(株) SDV事業開発部 ディレクター 日下 隆夫
Infotainment Systems, SDV Business Development Dept. Director Takahisa Hishida, Tokyo, Japan

注意事項 Caution

- <注意事項>**
- カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
 - ① 展示会場入場に必要な来場者パス①
 - ② カンファレンス受講に必要な受講券②
 - 敬称略、都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
 - テキスト(講演資料)の配付はございません。
 - カンファレンスの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。

*1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要ですが、来場登録後にメールにて届く「来場者パス」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
*2 カンファレンス申込後に届く申込券はメールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で展示し、当日カンファレンス上での提示、どちらでも可

- <Caution>**
- You have to prepare the following items for attending conference.
 1. Visitor Badge for entering exhibition.
*Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge can be sent to the e-mail you registered. Download and print and attach the visitor badge to entrance and bring it with you to the exhibition.
 2. Conference Ticket.
 - Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
 - Recording and photography are strictly prohibited.
 - Speakers and programs are subject to change.
 - Textbooks of keywords/special sessions are not available.

マイページは
こちらから
ACCESS MY PAGE FROM HERE

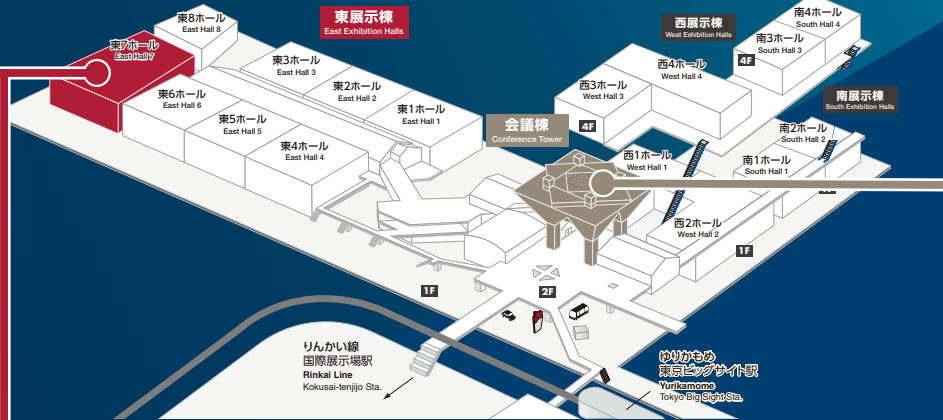
新規申込は
こちらから
REGISTER NEW SESSION FROM HERE

カンファレンスプログラム

CONFERENCE VENUE OVERVIEW

1月23日 [木]

Jan.23 [Thu.]



カンファレンス会場A CONFERENCE VENUE A

AUTO-EV3 10:00-11:30
2027年のxEVに求められる電気駆動システム(e-Axle)の技術潮流とそのシステムインパクト
Technical Trend and System Impact of Electric Drive Power Train (e-Axis) for xEV in 2027
名古屋大学 未来材料システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 山本 真樹
Toyota Motor, Future Material System Research Center, Future Electronics Integrated Research Center, Prof. Masaki Yamamoto

AUTO-EV51 12:30-13:40
マルチバスケイ戦略の鍵となる技術
Key Technologies for "Multi-baskey" Approach
トヨタ自動車(株) パワーtrainカンパニー フレジデント 上原 隆史
Toyota Motor, Powertrain Company President, Mr. Takashi Uehara

PDM-S2 15:00-16:10
パワーデバイス サミット ~パワーデバイスの現状と展望を徹底討論~
Power Device Summit: Panel Discussions on the Current Situation and Future Outlook of Power Devices
インフオニクテクノロジーズ ジャパン(株) イングストリアム&インフラストラクチャー 事業本部 事業本部長 加藤 毅
Infonix Technology Japan, Inc. Ingstrom & Infrastructure Business Dept. Business Director, Takashi Kato

AUTO-EV3 10:00-11:30
富士電機(株) 半導体事業本部 開発技術部 統括部長 大西 俊彦
Fujitsu, Semiconductor Business Dept. Development Technology Dept. Chief Manager, Shunichi Nishi

ROOM 16
パワーデバイス事業本部 アプリケーション戦略 アソシエイトフェロー(シニア) 渡部 雅也
Power Device Business Dept. Application Strategy Associate Fellow (Senior), Masahiko Watabe

カンファレンス会場B CONFERENCE VENUE B

NEPCON-S3 10:00-11:10
AIは産業をいかに変革するか ~要素技術から未来の姿まで徹底解説~
How AI is Transforming Industries - Explanation from Underlying Technologies to Future Prospects
富士通(株) 富士通研究所 人工知能研究所 所長 園田 俊浩
Fujitsu, Fujitsu Research Institute, AI Research Institute, Director, Shunohsuke Sonoda

WEA-S1 12:30-13:40
次世代ウェアラブルの誕生秘話! デバイス開発の最前線を追う
Frontiers of Wearable Device Development! The Inside Story of Next-Generation Wearables
サンテックグループ(R) リバースエンジニアリング(株) 社長 村上 水谷 治典
Santec Group (R) Reverse Engineering (Co., Ltd.) President, Mitsuhiro Murakami

注意事項 Caution

● 敬称略、都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
● テキスト(講演資料)の配付はございません。
● カンファレンスの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。

会議棟 CONFERENCE TOWER

7 国際会議場 INTERNATIONAL CONFERENCE HALL

ISP-3 10:00-11:30
次世代半導体パッケージにおける最先端実装技術動向
Leading Trends in Emerging Technology for Next-Generation Semiconductor Packaging
パッケージングソリューションセンター センター長 轟山 龍一
Packaging Solution Center, Center Director, Ryuuichi Goshima

AUTO-SDV4 12:30-14:00
SDVの次世代技術ロードマップと統合ECU開発
Next-gen. Technology Roadmap for SDV and Integrated ECU Development
トヨタ自動車(株) デジタルソフト開発センター ソフトウェア開発 チーフソフトウェアアーキテクト 今井 孝志
Toyota Motor, Digital Software Development Center, Software Development, Chief Software Architect, Takashi Imai

AUTO-ONS1 15:00-16:10
自動車の資源循環モデルの確立と最新技術開発
Establishment and Latest Cutting-edge Technologies for Circular Economy in Automobiles
道徳者 環境共生・経済環境部 総務 資源循環ビジネス推進室 資源循環ビジネス推進室長 河田 隆平
Michizuki, Environmental Coexistence/Economic/Environmental Dept. General Affairs, Resource Circulation Business Promotion Room, Resource Circulation Business Promotion Room Chief, Takahiro Kawada

AUTO-CN3 10:00-11:30
車体のカーボンニュートラルに向けた新技術
New Technology to Achieve Carbon Neutrality in Vehicle Body Production
東京製鐵(株) グリーンEV新車事業推進 プロジェクト上級マネージャー 中西 栄二郎
Tokai Steel, Green EV New Vehicle Business Promotion Project Senior Manager, Eiji Nakanishi

SLE-S1 13:00-13:40
サステナブルなロジスティクス構築を目指す ~オルビス流DX推進の取組み~
Aiming to Build Sustainable Logistics Infrastructure with Orbi's DX Promotion Initiatives
オスカー(株) SCM部 ロジスティクス推進グループマネージャー 柳田 和宏
Osaka, SCM Dept. Logistics Promotion Group Manager, Kazuhiro Yanagida

SLE-S2 15:00-16:30
M&Aは人手不足の運輸業を救うのか? 成功事例から学ぶ
Can M&A Solve the Labor Shortage in the Transportation Industry? Lessons From Successful Cases
フジノホールディングス(株) マーケティング部 執行役員 川上 義生
Fuji no Holdings, Marketing Dept. Executive Director, Yoshio Kawasaki

PWB-3 10:00-11:30
実用化が見えてきたガラスサブストレートの必要性、課題、世界動向について語る
Glass Substrates are beginning to be Put to Practical Use. Talk About Needs, Challenges and Global Trends
エスエム(株) 電子・材料・生産技術開発部 総務・発行技術開発課 長 吉川 眞一
Sumitomo, Dept. Management, Material & Manufacturing Engineering, Dept. Sec. & Material Technology Development, Sec. Chief, Masaru Yoshikawa

ISP-4 15:00-16:30
圧倒的な低消費電力化で半導体プレイヤーを変える光電融合技術
Optoelectronics - Ultra-low Power Consumption is a Game Changer for Semiconductors
(国) 産業技術総合研究所 プラットフォームフォトリソロジー研究センター長 鈴木 周
NISTEP, Research Center for Platform Photolithography, Center Director, Shuuji Suzuki

AUTO-MS2 10:00-11:10
世界のMaas事例 ~中国のロボタクシーや無人運転サービス社会を学ぶ~
(Case Studies) Overseas Maas - Robotics in China and Driverless Mobility Service
現代文化研究所 調査・研究本部 総務(総務) 上長(主任研究員) 八杉 理
Modern Culture Research Institute, Research Dept. General Affairs (General Affairs) Senior Researcher, Ritshi Yashiki

FIW-S4 12:30-13:40
中小企業のGXどう進める? 政府の取り組みと事例を紹介
Government Initiatives and Case Studies on GX for SMEs
経済産業省 GXチーム GX推進企画部長 萩野 淳平
Ministry of Economy, Trade and Industry, GX Team, GX Promotion Planning Director, Junpei Hagiwara

FIW-S5 15:00-15:40
バーチャルファクトリーの価値を考える
Considering the Value of Virtual Factories
エヌビディア(株) シニアビジネスデベロップメントマネージャー (DX/Omniverse) 中嶋 隆博
NVIDIA, Sr. Business Development Manager (DX/Omniverse), Takahiro Nakajima

FIW-S3 10:00-10:40
社会実装におけるヒューマノイドロボットの無限の可能性
Infinite Possibilities of Humanoid Robots in Social Implementation
Boston Dynamics Inc., Chief Strategy Officer, marc theermann

NEPCON-K 12:30-13:40
半導体における最新技術戦略と展望とは
Latest Technology Strategies and Future Outlook in Semiconductor
(国) 産業技術総合研究所 主任研究員 栗木 誠博
NISTEP, Senior Researcher, Makoto Akiyama

SK hynix Inc., HBM Design Dept., Director, Hyunwoo Kim
Amkor Technology Korea, Inc., R&D, VP Fellow, Product Dept. Group Manager, WonChul Do

PWB-4 15:00-16:30
次世代パッケージ基板技術の最前線
Cutting-edge Technologies in Next-generation Package Substrates
(国) 産業技術総合研究所 主任研究員 栗木 誠博
NISTEP, Senior Researcher, Makoto Akiyama

SK hynix Inc., HBM Design Dept., Director, Hyunwoo Kim
Amkor Technology Korea, Inc., R&D, VP Fellow, Product Dept. Group Manager, WonChul Do

マイページはこちら ACCESS MY PAGE FROM HERE

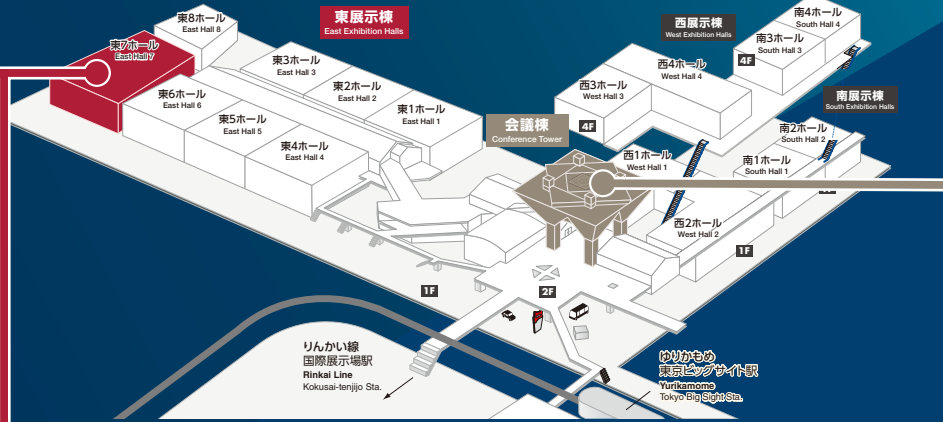
新規申込はこちら REGISTER NEW SESSION FROM HERE

カンファレンスプログラム

CONFERENCE VENUE OVERVIEW

1月24日 [金]

Jan.24 [Fri.]



カンファレンス会場A

CONFERENCE VENUE A

NEPCON-S4
10:00-11:10
はんだ最新線！国際規格と先端技術の最新動向
The Frontline of Soldering: Latest Trends in International Standards and Advanced Technologies

(株)東海理化 生産開発部 総合生産室 室長 鈴木 貞人
トヨタ自動車(株) デジタルソフト開発センター 電子性能開発部 グループ長 西森 久雄

AUTO-SDV52
12:30-13:40
ソフトウェアファーストが生み出す
新たなモビリティの価値
The New Value of Mobility Created by Software-first

(株)NTTデータ 取締役社長執行役員 有馬 勲
(株)デンソー 上席執行役員 モビリティエレクトロニクスグループ長 近藤 浩

PDM-S3
15:00-16:10
カーボンニュートラルを実現する
パワーデバイス技術とは
Power Devices which Help to Achieve Carbon Neutrality

(株)安川電機 執行役員 インバータ事業部長 兼 インバータ技術部長 博士(工学) 井手 耕三
(株)TMEIC 執行役員 パワーエレクトロニクスシステム事業部 事業部長 飛田 正孝

カンファレンス会場B

CONFERENCE VENUE B

WEA-S2
10:00-11:10
進化する建設現場！ウェアラブル導入で生まれた
建設現場革新の実例と成果
Case Study: Innovations in Construction Sites Driven by Wearable Devices

(株)竹中工務店 広島支店 生産総務部 プロダクトグループマネージャーフェーズパートナー 二宮 義典
オリンクス(株) 事業本部 第二チーム 統括 加藤 孝子
セーフィー(株) 事業本部2Cビジネスユニット 部長 進部 郁巳

AUTO-CN4
12:30-14:00
サーキュラーエコノミーを実現する
自動車のアルミニウムリサイクル技術
Recycling Technologies of Automotive Aluminum Parts for Circular Economy

(株)UACJ マーケティング/技術本部 R&Dセンターフェッダー 見島 洋一
日産自動車(株) 企画・先行技術開発本部 材料技術部 車両材料開発グループ主管 瀧島 文彦

AUTO-SDV5
15:00-15:50
SDV実現に向けた開発効率化へのアプローチとは？
Increasing Development Efficiency to Realise SDVs

ボッシュ(株) ボッシュモビリティ 東アジア-東南アジア 技術統括部門 技術統括-エンジニアリング統括 森田 泰弘

注意事項 Caution

- <注意事項>**
 - カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
 - ① 展示会場入場に必要な来場者パス①
 - ② カンファレンス受講に必要な受講券②
 - 敬称略、都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
 - テキスト(講演資料)の配付はございません。
 - カンファレンスの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。
- ① カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録にメールにて届く「来場者パス」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
② カンファレンス申込後に届く申込済メールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。(印刷・スマホ上での提示、どちらでも可)
- <Caution>**
 - You have to prepare the following items for attending conference.
 - 1. Visitor Badge for entering exhibition.
*Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the email you registered. Download and print with/without the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition.
 - 2. Conference Ticket.
*You must attach conference ticket attached with it to your email. Show the conference ticket (printed or show it on phone) at the reception of conference venue.
 - Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
 - Recording and photography are strictly prohibited.
 - Speakers and programs are subject to change.
 - Textbooks of Keyword/Special Sessions are not available.

マイページは
こちらから
ACCESS MY PAGE FROM HERE

新規申込は
こちらから
REGISTER NEW SESSION FROM HERE

会議棟 CONFERENCE TOWER

7
国際
会議場
INTERNATIONAL
CONFERENCE HALL

ISP-5
10:00-11:30
クルマの未来を切り開く
最新半導体テクノロジー
The Latest Semiconductor Technology to Open Up the Future of Cars

PWB-6
12:30-14:00
6Gに向けた次世代高速通信向けの
開発・技術動向
Next-generation high-speed application development and technology trend for 6G

6
606

FIW-56
10:00-11:10
見える化でカーボンニュートラル！
スコープ3を見据えた取り組み
Carbon Neutral Manufacturing by Visualization, with Scope 3 in Mind

AUTO-EV4
12:30-14:00
次世代モータ開発
～環境、調達リスクの2大課題解決へ～
Next-Gen. Motor Development - To Overcome Environmental & Procurement Risks

SLE-S3
15:00-16:10
サステナブルでグリーンな物流を実現！
先進的な取り組みから学ぶ
To Achieve Sustainable Logistics: Learn From Latest Case Studies

1
レセプション
ホール
RECEPTION HALL
A

FIW-C
14:00-16:00
生成AIがもたらす製造現場の変革
Generative AI Will Transform the Manufacturing Workplace

1
レセプション
ホール
RECEPTION HALL
B

PWB-5
10:00-11:30
パワーデバイスの活用に向けた
パッケージング技術と部品内蔵基板技術
Semiconductor Packaging and Embedding PCB Technology to Utilize Power Devices

ISP-6
12:30-14:00
次世代パワーデバイスと
先端パワエレモジュールの世界
World of Next-Generation Power Devices and Advanced Power Electronics Modules

FIW-S7
15:00-15:40
5Gによる工場のDX化推進
Promotion of Factory DX Using 5G

(株)NTT-E Chief Standardization Officer 中村 健哉